

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2017-027

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日下午收到上海证券交易所《关于对苏州晶方半导体科技股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0500号），针对问询函的问题，特作回复如下：

**问题一、关于公司业绩持续下滑。**自2014年2月10日上市以来，公司经营业绩持续下滑。年报显示，公司近三年实现营业收入分别为6.16亿元、5.76亿元和5.12亿元，归属于上市公司股东净利润分别为19,631万元、11,328万元和5,275万元，2015年同比下降42.30%，2016年同比下降53.43%。请公司补充披露：（1）结合公司近三年前五名客户及销售额变化情况，说明客户是否存在流失，对主要客户是否存在依赖；（2）结合行业发展趋势、市场竞争格局等因素，补充披露业绩持续下滑的具体原因，并说明后续拟采取的应对措施。

回复说明：

**（1）结合公司近三年前五名客户及销售额变化情况，说明客户是否存在流失，对主要客户是否存在依赖**

公司近三年前五名客户合计营业收入情况表：

客户名称	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
前五名客户营业收入合计（万元）	36,075	40,808	55,827
前五名客户占公司全部营业收入的比例（%）	70.41	70.88	90.66

公司近三年前五名客户营业收入明细表：

客户	2016年度（万元）	占全年营业收入比例（%）
客户A	19,695	38.44
客户B	6,017	11.74
客户C	3,598	7.02
客户D	3,437	6.71
客户E	3,328	6.50
合计	36,075	70.41

客户	2015年度（万元）	占全年营业收入比例（%）
客户A	18,745	32.56
客户F	8,393	14.58
客户G	5,641	9.80
客户D	4,712	8.19
客户H	3,317	5.76
合计	40,808	70.88

客户	2014年度（万元）	占全年营业收入比例（%）
客户F	20,965	34.04
客户D	13,159	21.37
客户A	11,133	18.08
客户I	5,597	9.09
客户H	4,973	8.08
合计	55,827	90.66

从近三年前五名客户合计营业收入占比来看，公司对前五名客户销售收入的比重逐年下降，主要原因是公司不断加强市场拓展与客户开发，有效扩展了市场应用领域与核心客户群，客户多样化与数量持续提升。同时，从近三年前五名客户的营业收入明细来看，前五名客户的结构不断变化，同一客户营业收入在不同年份比重与排序不断变化，某些客户在某些年份未出现在前五大名单中，主要为

不同年度中公司对不同客户的销售比重变化所致，其中客户I为公司2014年第四大客户，客户F为公司2015年第二大客户，2016年其分别为公司的第六大和第七大客户，相关客户均持续为公司的核心客户，因此，公司近三年不存在客户流失情况，也不存在对主要客户依赖的情况。

**(2) 结合行业发展趋势、市场竞争格局等因素，补充披露业绩持续下滑的具体原因，并说明后续拟采取的应对措施**

公司专注于传感器领域的先进封测技术服务，封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等。2015年以来，随着全球智能手机市场趋于饱和、销量增速逐年放缓，消费电子领域市场环境由以往的增量市场转变为存量市场，行业整体需求疲软，业务与市场竞争激烈程度不断上升，市场销售价格下降。同时，公司2014年底收购智瑞达科技相关资产，相应增加了公司的运营管理费用，但收购的资产与业务尚处于业务整合调整期，协同效应尚未显现。从而导致公司2015年、2016年业绩持续下降。

公司全球同行业主要竞争对手为台湾上市公司精材科技(股票代码: 3374)，受到上述行业环境影响，其经营业绩也呈现与行业环境类同的发展趋势，其近几年经营数据如下表：

项目	2016年	2015年	2014年
营业收入(新台币千元)	3,920,698	4,878,088	4,934,078
净利润(新台币千元)	-636,819	146,799	628,653

注：数据来源于精材科技公司网站披露的年度报告

面对激烈竞争的市场环境与经营业绩下滑，公司采取了以下相关应对措施，并开始取得显现效果：

- ①技术上。不断提升8寸、12寸3D TSV封装技术工艺能力与生产效率，巩固并提升公司的技术领先与市场规模优势；加强对生物身份识别芯片封装技术的持续创新，通过对收购智瑞达资产的模组技术进行刻制创新与有效整合，具备Trench、TSV、LGA等全面多样化封装技术及全方案服务能力；积极发展高阶产品fan-out封装技术、汽车电子产品封装技术等开发与认证，取得有效进展；着力于测试、模组技术的开发与提升，实现业务与技术的有效延伸与产业链拓展。
- ②市场上。加强客户拓展，不断提升核心客户群体，保持与全球主要设计公司的

战略合作；强化优势业务，提高市场占有率，加强影像传感芯片、生物身份识别芯片等优势业务领域的技术工艺创新，延伸产业链，缩短生产周期，快速满足不断变化的市场需求，把握双摄像头兴起、指纹锁持续普及与工艺不断创新的市场机遇；加强新产品与新应用市场的拓展，并在安防监控、MEMS等领域取得有效发展，在生物身份识别模组业务取得突破，在VR/AR、3D摄像等新兴市场取得有效拓展；努力着力于汽车电子、智能制造等工业领域的专利积累、工艺认证与市场拓展，把握未来汽车电子、智能制造等传感器市场的发展机遇。

通过上述应对措施，对公司2017年一季度经营产生显著效果，2017年一季度业绩较去年同期相比增长显著，具体情况如下：

项目	2017年一季度	2016年一季度	增幅
销售收入（万元）	13,201.51	12,256.82	7.71%
净利润（万元）	2,328.38	1,608.95	44.71%

**问题二、关于分季度业绩不均衡。**2016年各季度，公司销售收入分别为1.23亿元、1.16亿元、1.12亿元和1.61亿元，实现扣非后净利润分别为1053万元、417万元、75万元和1826万元，季度间差异较大。请公司补充披露：（1）四季度收入明显高于前三季度的原因，公司业务是否存在周期性，四季度是否存在关联销售，如有，请说明对关联方的收入与前三季度是否存在重大差异；（2）公司四个季度主营业务的净利率分别为8.59%、3.60%、0.67%和11.27%，请说明各季度间净利率差异较大的原因。

回复说明：

（1）**四季度收入明显高于前三季度的原因，公司业务是否存在周期性，四季度是否存在关联销售，如有，请说明对关联方的收入与前三季度是否存在重大差异**

①2016年度公司分季度销售收入情况：

项目	一季度	二季度	三季度	四季度
销售收入(万元)	12,256.82	11,583.71	11,203.19	16,195.30
销售收入变化幅度	—	-5.49%	-3.28%	44.56%

公司业务无明显周期性，前三季度主营业务收入变化幅度较小，四季度收入增长较快，主要原因是随着手机双摄像头的兴起、生物身份识别功能快速普及与

工艺创新要求、3D摄像等新兴应用的产生，行业景气度回升。面对市场的激烈竞争与快速变化，公司相关应对措施效果开始显现，在影像传感器、生物身份识别芯片等领域的技术、工艺、生产效率提升方面加大投入，充分把握市场发展机遇，快速进行市场布局调整，加大新客户的开发力度。同时根据产品市场价格变化情况，适时调整、优化业务与订单结构。

②各季度关联销售情况

公司2016年各季度对关联方OmniVision Technologies Singapore Pte Ltd（以下简称OV）的销售情况如下：

项目	一季度	二季度	三季度	四季度
销售额（万元）	5,385.87	4,095.96	4,720.60	5,492.62
占营业收入比重	43.94%	35.36%	42.14%	33.91%

从表中数据来看，对OV销售额季度间有所波动，趋势与整体市场变化情况相符，第四季度销售额较前三季度并不存在重大差异。

（2）公司四个季度主营业务的净利率分别为8.59%、3.60%、0.67%和11.27%，请说明各季度间净利率差异较大的原因。

①2016年度各季度主要经营数据情况

单位：万元

项目	一季度	二季度	三季度	四季度
营业收入	12,256.82	11,583.71	11,203.19	16,195.30
营业成本	8,528.48	8,799.55	7,335.08	10,066.20
期间费用	2,330.84	2,087.12	3,496.65	3,982.60
其中：管理费用	2,289.22	2,847.65	3,809.29	5,006.04
财务费用	-10.88	-815.08	-375.38	-1,094.23
净利润	1,608.95	983.34	433.95	2,249.08
扣非后净利润	1,052.92	417.33	75.35	1,825.70
毛利率	30.42%	24.04%	34.53%	37.83%
期间费用率	19.02%	18.02%	31.21%	24.60%
扣非后净利润率	8.59%	3.60%	0.67%	11.27%

各季度对扣非后净利润率产生影响的项目主要包括毛利率、管理费用和财务

费用。

## ②净利润率变动原因分析

净利润率二季度较一季度下降 4.99 个百分点，其中毛利率及期间费用率下降共同导致净利率下降 5.38 个百分点；毛利率下降 6.38 个百分点，主要原因是二季度产销量较低，单位产品分摊的固定成本较高，以及产品价格下降；期间费用率下降 1 个百分点，主要原因是汇率上升，财务费用中的汇兑收益增加金额较大。

净利润率三季度较二季度下降 2.93 个百分点，其中毛利率及期间费用率上升共同导致净利率下降 2.70 个百分点；毛利率上升 10.49 个百分点，主要原因是毛利率较高产品销售占比提高与产品综合价格回升；期间费用率上升 13.19 个百分点，主要原因是公司研发投入增加及汇兑收益减少，管理费用和财务费用相应增加。

净利润率四季度较三季度上升 10.60 个百分点，其中毛利率上升及期间费用率下降共同导致净利率上升 9.91 个百分点；毛利率上升 3.3 个百分点，主要原因随着市场行情逐渐回暖，主要产品产销量增加，单位产品分摊的固定成本进一步下降；期间费用率下降 6.61 个百分点，主要原因是收入增长幅度高于期间费用的增长幅度，期间费用增长主要是研发投入及汇兑收益增加。

**问题三**、Omnivision Technologies Singapore Pte Ltd（以下简称OV）是公司的关联方，2014年、2015年和2016年公司向对方销售商品/提供劳务分别实现收入1.11亿元、1.87亿元和1.97亿元，占同期收入的18.02%、32.50%和38.48%，与OV之间的关联交易占比较高。请补充披露：（1）公司与OV之间关联交易的内容，近三年应收账款及回款情况；（2）近三年关联交易的定价依据，与其他客户相比，关联交易的定价是否存在重大差别。

回复说明：

### （1）公司与OV之间关联交易的内容，近三年应收账款及回款情况

OV为全球影像传感器芯片主要设计公司之一，2015年其影像传感器芯片在全球市场占有率为12%。公司近三年与OV交易、应收账款及回款情况如下：

单位：万元

年度	交易金额	年末应收账款	期后回款	交易内容
2016年度	19,695	3,845	3,845	芯片封装
2015年度	18,745	1,800	1,800	芯片封装
2014年度	11,133	1,942	1,942	芯片封装

**(2) 近三年关联交易的定价依据，与其他客户相比，关联交易的定价是否存在重大差别**

公司与OV的交易定价依据为成本加成原则，与其他客户的定价原则一致。公司近三年与OV的交易单价与其他客户交易单价类同，交易定价不存在重大差别。

**问题四、**公司专注于传感器领域的封装测试业务。依年报分类口径，公司产品可以分晶圆级封装和非晶圆级封装，其中非晶圆级封装本期销售4588.67万颗，相比去年减少40.59%。请公司补充披露非晶圆级封装本期销售减少的原因，并依上述口径补充披露两类产品的收入、成本、毛利率等经营性信息。

回复说明：

公司非晶圆级封装产品系收购智瑞达科技相关的DRAM封测业务，鉴于DRAM市场高度集中化特征，且DRAM市场非公司主营业务，公司近两年一直致力于努力将收购的相关资产与技术进行互补融合，并将其技术与生产能力转换调整到公司专注主营的影像传感器、生物身份识别等传感器市场领域，并延伸拓展公司的产业服务能力，从而导致DRAM等非晶圆级产品封装量与销售收入下降。2016年度公司晶圆级与非晶圆级产品的收入、成本、毛利率经营性信息如下：

产品	收入	成本	毛利率
晶圆级封装产品（万元）	44,718.01	29,667.63	33.66%
非晶圆级封装产品（万元）	5,394.56	4,813.16	10.78%

**问题五、**关于应收账款周转缓慢。公司2016年末应收账款余额1.10亿元，较去年增长112.31%，应收账款周转率4.65，较去年大幅下降。请公司结合收入、赊销政策、信用期等补充披露应收账款周转率大幅下降的原因，公司销售政策是否发生变化。

回复说明：

公司 2016 年末应收账款余额 1.1 亿元，较去年增长 112.3%，主要系公司第四季度销售规模同比大幅上升，2016 年第四季度公司实现销售收入 1.62 亿元，较 2015 年同期销售收入 1.24 亿元增加了 3,824 万元，从而使得 2016 年期末应收账款余额增加较大，相关应收账款期后均已正常回款。公司制定了严格的应收账款管理制度，销售业务中严格有效按照业务约定收款，赊销政策、信用期等销售政策未发生变化。2016 年、2015 年公司应收账款年度平均回收天数分别为 58 天、47 天，2016 年略有延长主要是由于四季度销售规模大幅上升，导致期末应收账款增加较多所致。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日